

46-416 Economy Version

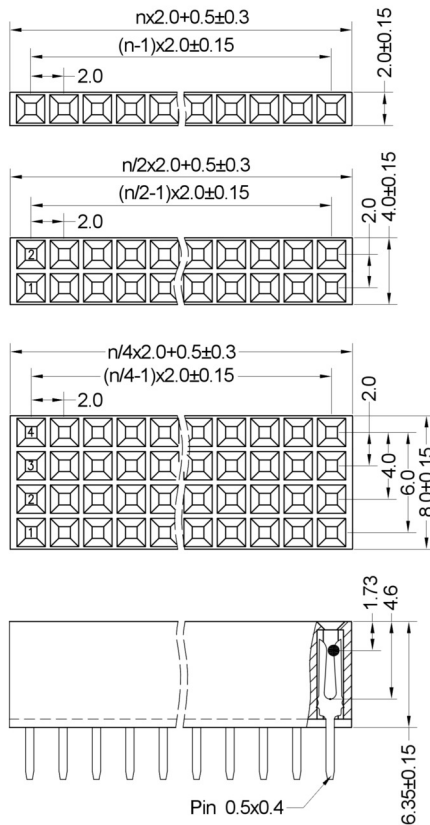
Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-/4-reihig - BH 6,35mm
 Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, 1/2/4 Rows – 6.35mm Profile

Technische Daten / Technical Data

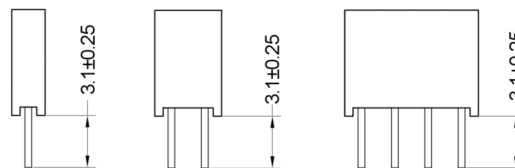
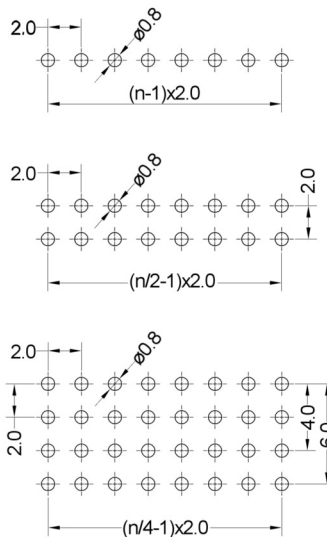
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	1,5 A
Current Rating	1.5 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.
 Fork contacts accept 0.50mm square pins.



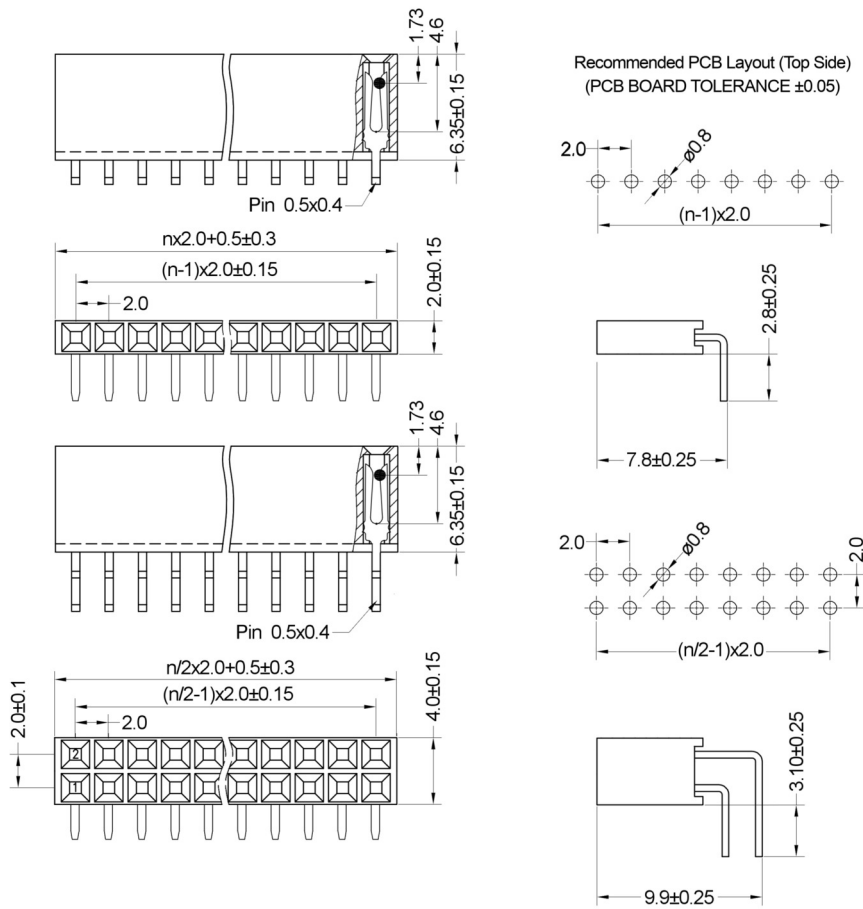
Recommended PCB Layout (Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series	Contacts*	Rows*	Type	Dimensions	Plating
46-416	020 002-040 Einreihig Single row 004-080 Zweireihig Double row 008-160 Vierreihig Four row	1 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row 4 Vierreihig Four row	1 1 Gerade Straight	10 10 C=3,1mm	00 00 Vergoldet Gold plated

46-416 Economy Version

Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-/4-reihig - BH 6,35mm
 Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, 1/2/4 Rows – 6.35mm Profile



Series

46-416

Contacts*

022

002-040 Einreihig
 Single row
004-080 Zweireihig
 Double row

Rows*

1

1 Einreihig
 Single row
2 Zweireihig
 Double row

Type

2

2 Gewinkelt
 Right-angled

Dimensions

10

10 C=2,8mm (Einreihig)
 C=3,1mm (Zweireihig)
 C=2,8mm (Single row)
 C=3,1mm (Double row)

Plating

00

00 Vergoldet
 Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

